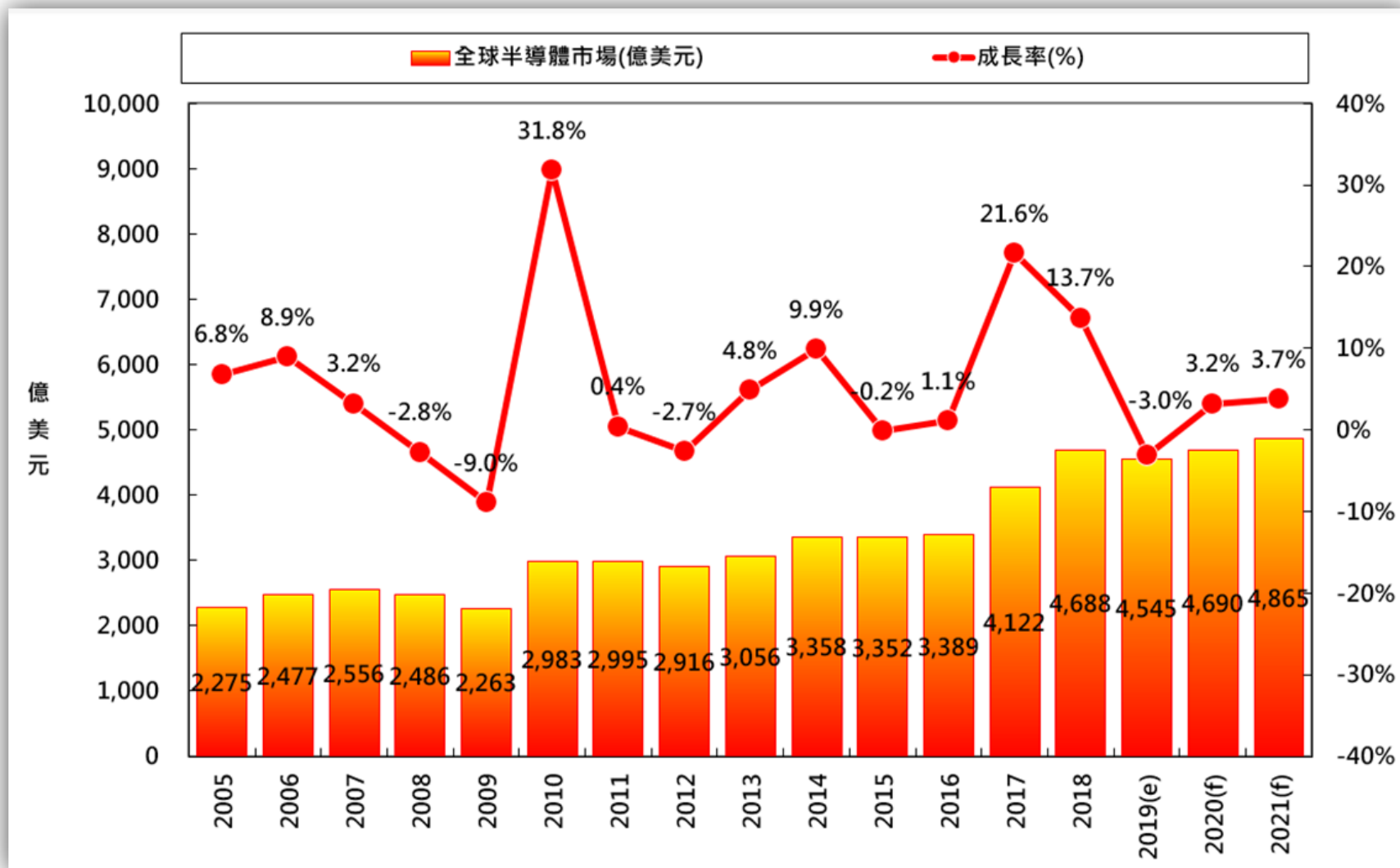


半導體 產業現況

2018年全球半導體市場達美金4,688億，成長13.7% 預估2019年市場值達美金4,545億，衰退3.0%



資料來源：WSTS、工研院ISTI、SIPO整理 (2019/04)

2018年台灣IC產業在全球具重要地位

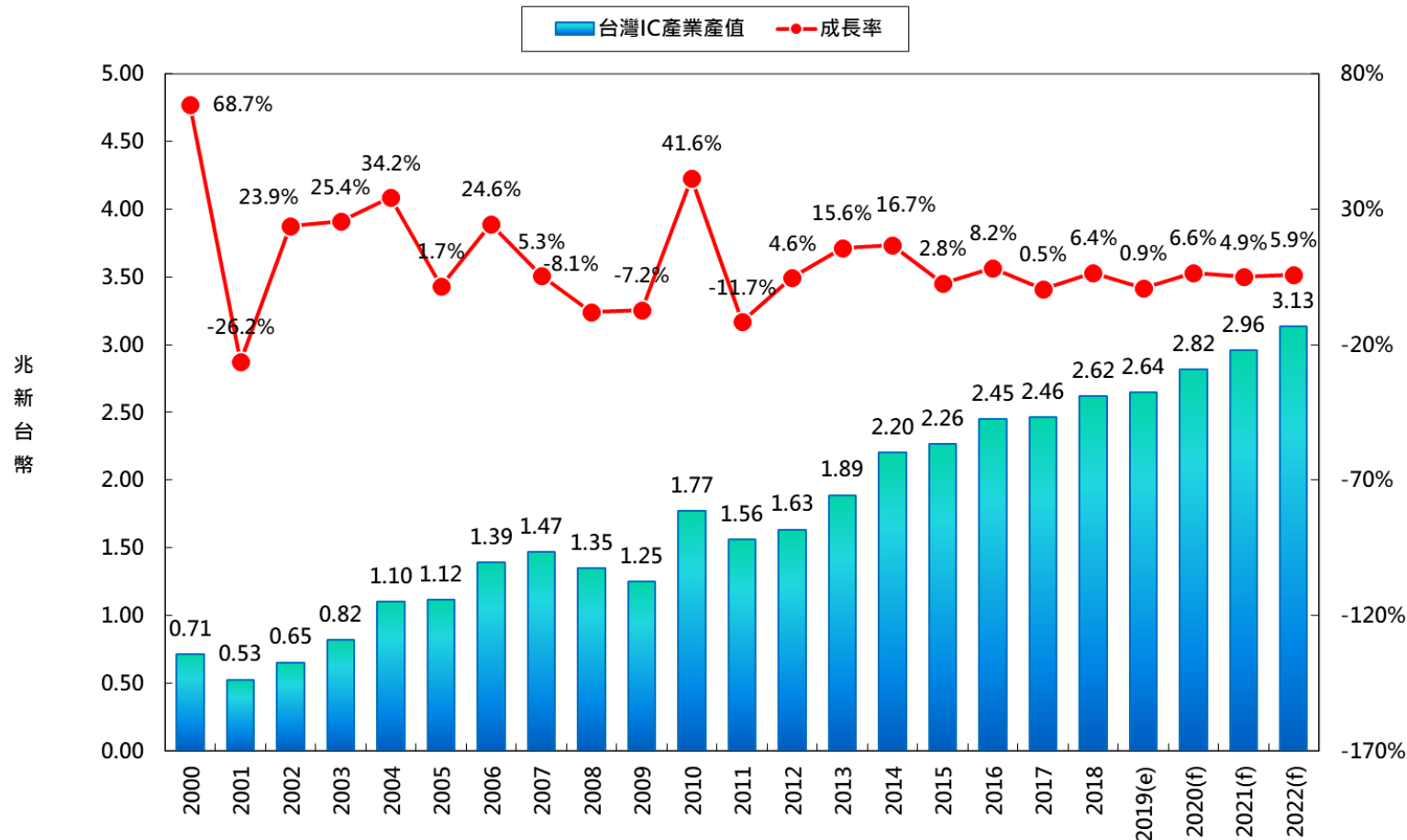
總IC產值全球第三

(IC設計No.2、晶圓代工No.1、IC封測No.1)

2018年	台灣產值 (億美元)	全球產值 (億美元)	台灣佔有率 (%)	台灣 排名	台灣 大廠	領先國
IC產業鏈產值 = A+B+C+D	868	5,812	14.9%	No.3	台積電	韓, 美
A.IC設計	212	1,234	17.2%	No.2	聯發科	美
B.IDM(含記憶體)	66	3,694	1.8%	No.5	南亞科	韓, 美, 日, 歐
C.晶圓代工	427	592	72.2%	No.1	台積電	台
D.IC封測代工	163	292	55.9%	No.1	日月光	台
IC產品產值(IC品牌) = A+B	278	4,928	5.6%	No.4	聯發科	韓, 美, 日

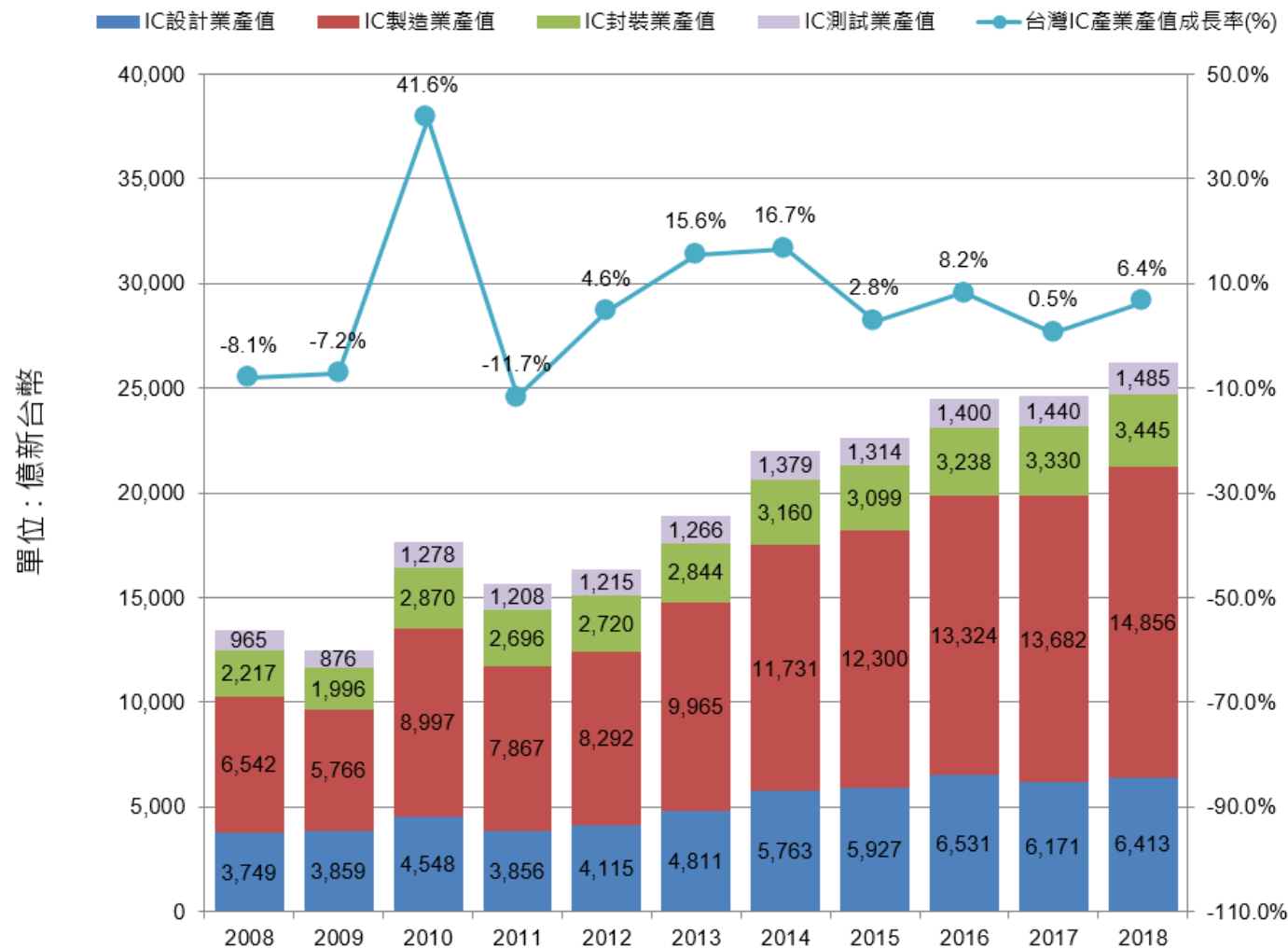
- 台灣IC產業上下游產業鏈完整，從上游的IC設計到後段的IC製造與IC封測，專業分工模式獨步全球，總IC產值全球排名第3，僅次於美國和韓國(超過日本、歐洲、中國大陸、新加坡)。
- 台灣IC設計產值全球排名第2，僅次於美國(超過中國大陸)。
- 台灣IDM排名全球排名第5，其中記憶體產值全球排名第4，以DRAM為主，其次為NOR Flash及Mask ROM，僅次於韓國、美國、日本。
- 台灣晶圓代工產值全球排名第1，居全球領導地位，先進製程邁入7nm以下。
- 台灣IC封測產值全球排名第1，全球前十大專業封測業者中，台灣佔有一半以上。

2018年台灣半導體產業產值達新台幣2.62兆元，穩定成長6.4% 隨著經濟景氣趨於保守，預估2019年僅成長0.9%，甚至負成長



- 2018年台灣半導體產業產值達2.62兆元(成長6.4%)，預估2019年達2.64兆元(成長0.9%)。
- 台灣IC產業上下游產業鏈完整，從上游的IC設計到後段的IC製造與IC封測，專業分工模式獨步全球，總IC產值全球排名第3(市佔約二成)，次於美國和韓國。
- 台灣IC設計產值全球排名第2(市佔約二成)，台灣晶圓代工產值全球排名第1(市佔約七成)，台灣IC封測產值全球排名第1(市佔約五成)，台灣記憶體產值全球排名第4(市佔約一成)。

2018年台灣晶圓代工、IC設計、IC封測穩健成長 記憶體具高成長動能



資料來源：工研院ISTI、SIPO整理 (2019/04)